

過去のニュース2015年度
(2015年1月～12月)

掲載日	内容
015.06.29	就業時間変更のお知らせ
2015.05.27	電子デバイス向けスパッタリングシステム「RRシステム」を開発

2015年6月29日
キャノントッキ株式会社

就業時間変更のお知らせ

弊社では、下記対象期間において就業時間を変更いたします。関係される皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象期間 2015年7月1日（水）～9月30日（水）

2. 始業時刻・終業時刻

事業所	現行		対象期間	
	始業時刻	終業時刻	始業時刻	終業時刻
本社／見附事業所 平塚事業所 九州サービスステーション 北陸サービスステーション	8：30	17：00	8：30	16：45

※東京オフィス、関西サービスステーションは就業時間の変更はありません。

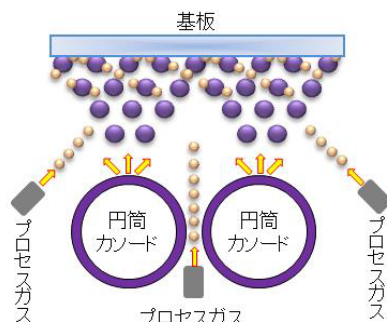
3. 変更の理由

弊社およびキャノングループでは『働き方改革』として、『業務効率化・生産性向上への取り組み』と『仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）』を推進しております。今回の就業時間変更は具体的施策の一つとなります。

以上

**電子デバイス向けスパッタリングシステム「RR システム」を開発
膜厚均一性±2.1%と成膜速度 2 倍の高速化を同時に実現**

キヤノントッキ株式会社（本社：新潟県見附市新幸町 10-1）は、膜厚均一性を±2.1%へ向上させると同時に成膜速度を 2 倍に高速化する「RR システム」を開発しました。



RR システムの概要

RR (Reactive Rotary-cathode、通称 ダブルアール) システムは、従来のスパッタリング装置に複数の小型円筒カソード^{※1}を配置し、反応性スパッタリング^{※2}技術と融合させた独自の技術で、膜厚均一性の向上や高速成膜、そして高い材料使用効率を実現するシステムです。

同システムを搭載したスパッタリング装置は、従来の円筒カソードと比較して膜厚均一性を±5.1%から±2.1%へ向上させるとともに、成膜速度を 2 倍まで高めることを実現しました。さらに、プレーナー型カソード^{※3}と比較し、材料使用効率を 40%から 80%へ高めることで、トータルランニングコストの低減を可能としました。

この RR システムをスパッタリング装置「SPL シリーズ」や「SPS シリーズ」に搭載することで、用途が拡大する電子デバイス業界において、特に SAW デバイス^{※4}や FBAR デバイス^{※5}、実装基板^{※6} 向けのスパッタリング装置として提案し、お客さまの生産性向上と電子デバイス業界の発展に貢献します。本システムを搭載した装置は、2015 年 9 月に製品化することを目指しています。

なお、これらの装置や技術については、2015 年 6 月 3 日（水）から 6 月 5 日（金）まで東京ビッグサイトで行われる「JPCA Show 2015」のキヤノントッキブースでもご覧いただけます。

- ・ イベント名： JPCA Show 2015
- ・ 日 時： 2015 年 6 月 3 日（水）～6 月 5 日（金）
- ・ 場 所： 東京ビッグサイト（東 4 ホール、キヤノントッキブース： 4G-14）

※1 円筒カソード： スパッタリングのターゲット材を円筒形にしたカソード。
 ※2 反応性スパッタリング： ターゲット材とプロセスガスを反応させるスパッタリング成膜法。
 ※3 プレーナー型カソード： スパッタリングのターゲット材を平板形にしたカソード。
 ※4 SAW デバイス： Surface Acoustic Wave（表面弾性波）デバイス。必要な周波数の電気信号を取り出し、不必要な周波数の電気信号をフィルタリングするデバイス。
 ※5 FBAR デバイス： Film Bulk Acoustic Resonator（圧電薄膜共振子）デバイス。シリコンを利用し、送受信間隔が狭い部分に利用され、高周波対応に優れているといった特長があるデバイス。
 ※6 実装基板： 基板の上に各種電子デバイスを搭載した回路基板。